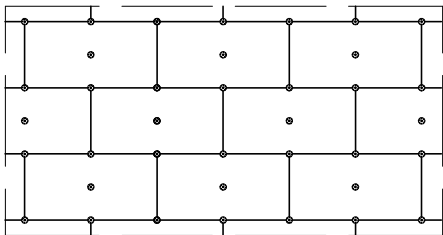
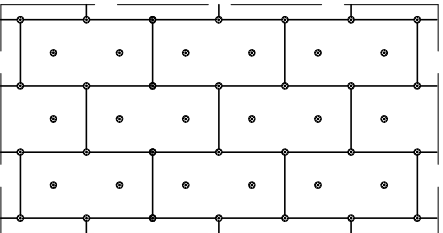
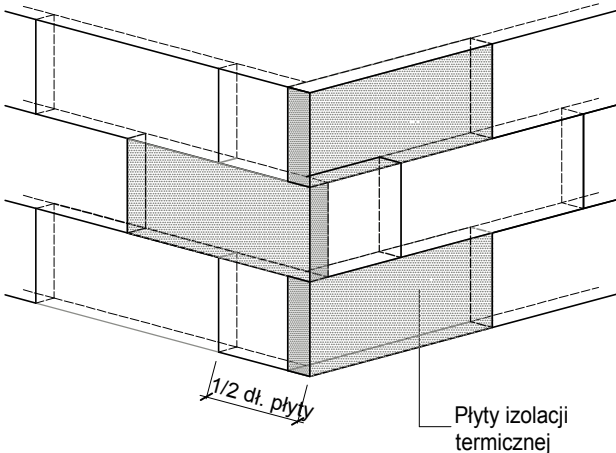
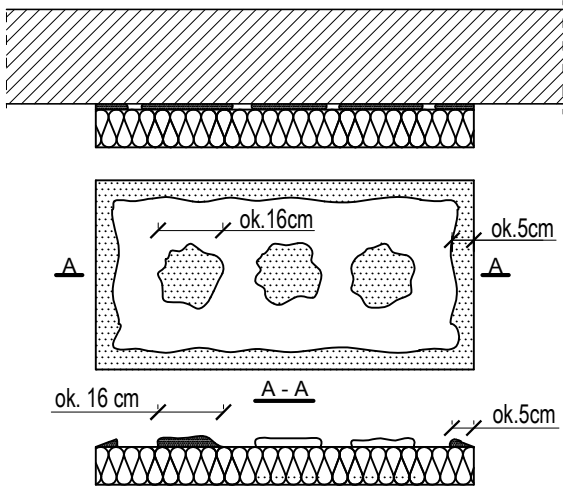


<p>Detal 1.1 Rozmieszczenie łączników mocujących płyty izolacji termicznej (100 x 50 cm). Powierzchnia fasady.</p>	<p>Detal 1.2 Ułożenie płyt izolacji termicznej - naroże.</p>	<p>Detal 1.3 Sposób klejenia płyt izolacji termicznej.</p>
<p>Wariant I - ilość łączników 6 szt./m²</p>  <p>Wariant II - ilość łączników 8 szt./m²</p> 		 <p> $\frac{P_e}{P} \times 100 \% / 40\%$ </p> <p>Pe - efektywna powierzchnia przyklejenia płyty termoizolacyjnej do podłoża P - powierzchnia płyty termoizolacyjnej przylegająca do ściany</p>
<p>UWAGI :</p> <p>Do mocowania mechanicznego można przystąpić nie wcześniej niż po upływie 24 h od przyklejenia płyt. Zastosowanie łączników mechanicznych nie może spowodować wichrowania się i lokalnego podnoszenia się płyt.</p> <p>Długość łączników powinna wynikać z rodzaju podłoża oraz grubości materiału izolacji termicznej, przy czym głębokość zakotwienia w podłożu powinna wynosić co najmniej 6 cm.</p> <p>Należy stosować łączniki:</p> <ul style="list-style-type: none"> - plastikowe (w przypadku ocieplenia płytami styropianowymi), - z trzpieniem metalowym wbijanym lub wkręcnym (w przypadku ocieplenia z wełny mineralnej oraz gdy wyprawę wierzchnią stanowią płytki klinkierowe bądź gresowe). 	<p>UWAGI :</p> <p>Płyty izolacji termicznej przykleja się pasami od dołu do góry, po uprzednim przymocowaniu listwystartowej. Płyty należy mocować do podłoża poziomo (wzdłuż dłuższej krawędzi) z zachowaniem mijankowego układu spoin pionowych. Nie mogą tworzyć się spoiny krzyżowe.</p> <p>Spoiny płyt nie mogą przebiegać w narożach otworów (np. okien), ani na rysach i pęknięciach w ścianie oraz na przejściach między różnymi materiałami ściennymi. Na całej powierzchni ocieplenia ściany płyty powinny dokładnie przylegać do siebie.</p> <p>Na ścianach z prefabrykatów, płyty izolacji termicznej należy tak przyklejać, aby styki między nimi nie pokrywały się ze złączami ścian.</p> <p>Niedopuszczalne jest występowanie masy klejącej w spoinach.</p>	<p>UWAGI :</p> <p>Do klejenia izolacji termicznej używa się fabrycznie przygotowanych dyspersyjnych mas klejowych, w przypadku podłoża nienasiąkliwych i drewnopochodnych, lub zapraw klejowych do zmieszania z wodą na budowie w przypadku typowych podłoży budowlanych. Zaprawę klejową należy przygotowywać według zaleceń producenta (instrukcje i karty techniczne) również w przypadku fabrycznie przygotowanych klejów dyspersyjnych, które wymagają zmieszania z cementem celem przygotowania właściwej zaprawy klejowej.</p> <p>Klej należy nanosić na płyty izolacyjne według tzw. metody pasmowo-punktowej. Na płytę nanosić taką ilość zaprawy, aby uwzględniając odchyłki równości podłoża i możliwą do położenia warstwę kleju (ok. 1 do 2 cm) zapewnić minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejenia płyty do podłoża (przy większych nierównościach należy stosować zróżnicowanie grubości izolacji). Po obwodzie płyty wzdłuż jej krawędzi należy nanieść około 5 cm szerokości pasmo zaprawy i dodatkowo w środku płyty nałożyć minimum 3 placki zaprawy wielkości dłoni. Na równych podłożach można nakładać zaprawę na płytę termoizolacyjną całościowo przy użyciu pacy zębatej (ok. 10 mm).</p> <p>W przypadku zastosowania płyt lamelowych z wełny mineralnej - klejenie metodą "grzebieniovą"</p>